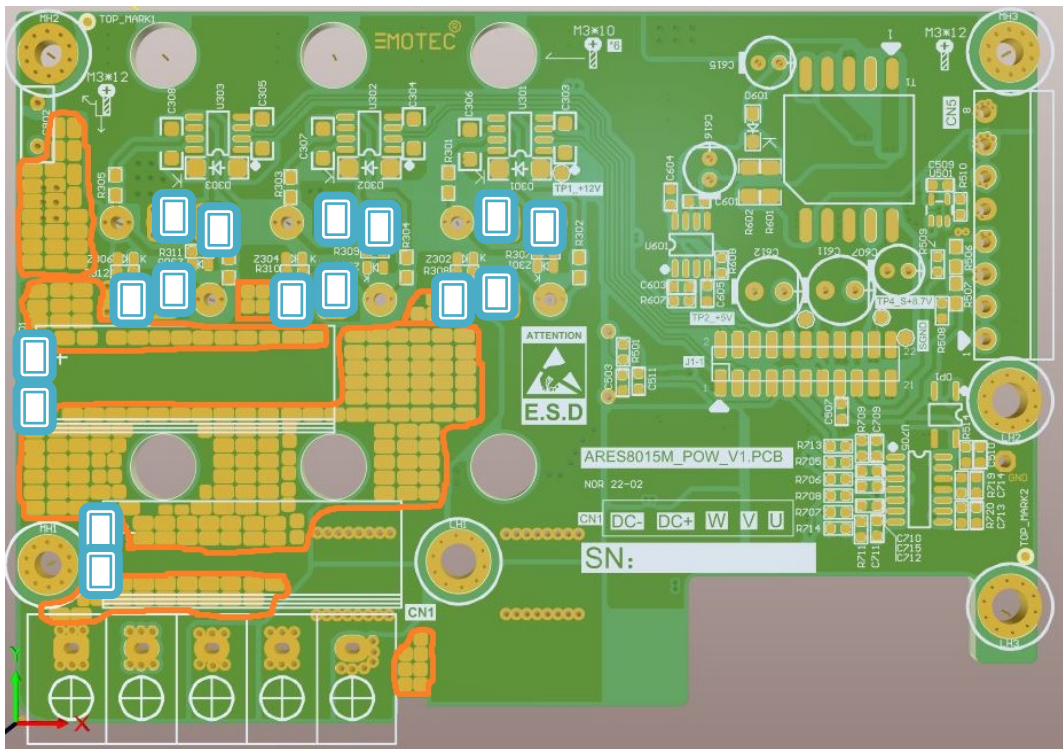


PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	ARES8015M_POW_V1	焊接	QM03322021901	V1	1/2	20220219

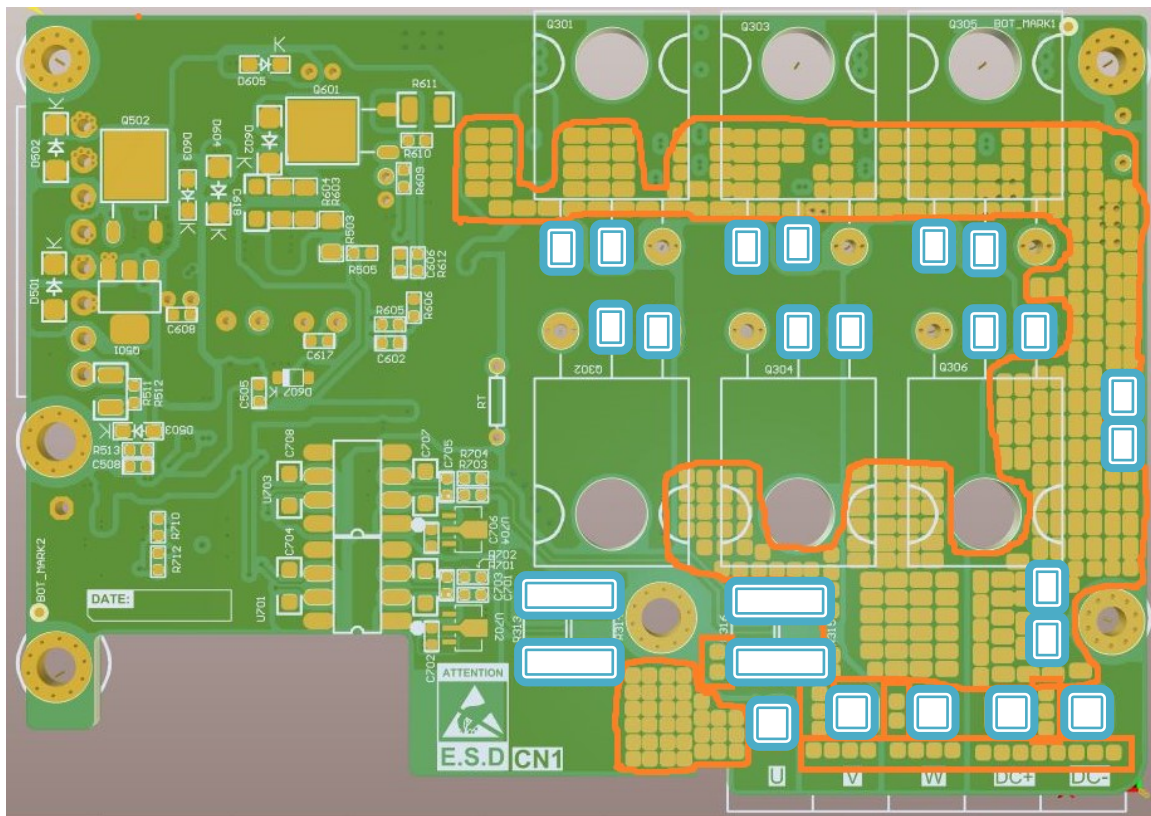
1. ARES8015M_POW_V1 加锡位置(即除元件焊盘外, 所有裸露焊盘[露铜位置]进行加锡)

顶层



- 1) 橙色框内 PAD 加锡, 加锡厚度为 0.2mm;
- 2) 蓝色双线框内半透明覆盖的 PAD 区, 要求每个通孔内上下焊锡通透 (灌满焊锡);

底层



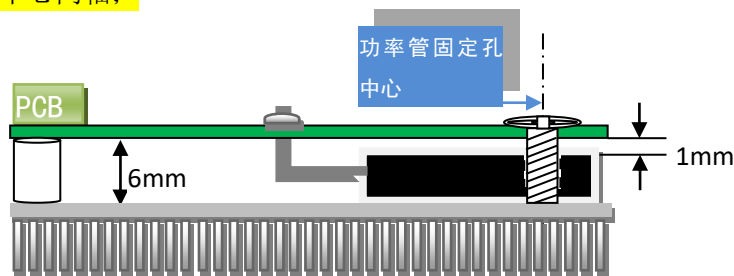
- 1) 橙色框内 PAD 加锡, 加锡厚度为 0.2mm;
- 2) 蓝色双线框内半透明覆盖的 PAD 区, 要求每个通孔内从底层至顶层注满焊锡;
- 3) CN1 端子, 底层加锡焊接, 焊锡熔化后, 电烙铁仍要停留 2~3 秒, 保证焊锡从过孔完全流到板子顶层.

PCB 焊接	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
工艺要求	直流伺服	ARES8015M_POW_V1	焊接	QM03322021901	V1	2/2	20220219

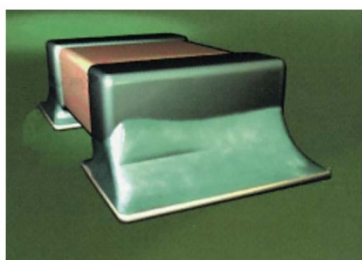
2. 焊接基本要求

1) 功率管 Q301~ Q306 共计 6 个 (T0-247 封装的管子), 管脚直角折弯

- 高度: 功率管的下表面 (金属部分) 距离 PCB 下表面 6mm 焊接; 且要求功率管脚顶层和底层双面焊接;
- 焊接后, 功率管固定孔中心与 PCB 开孔中心同轴;

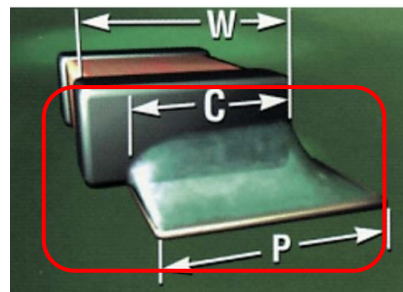


2) 电阻 R313~R316 (4 个) 要求焊接完成后, 保证元件不偏移, 见下图 (元件的电极与相应焊盘位置重叠)



目标 - 1, 2, 3 级

- 末端连接宽度等于元器件端子宽度或焊盘宽度, 取两者中的较小者。



可接受: a) 端子 (A) 的侧面偏移不大于端子宽度的 5% (约 0.15mm, 下图为焊接不良图片)。

b) 端子连接宽度在与焊盘接触区域有 100% 润湿

备注: 该位置要求 100% 目检, 不符合要求的, 拒收!

3) 贴片螺母焊接要求:

- LH1 位置焊接 SMTS03011CTJ (M3*11 不带螺纹支撑柱)
- LH2~LH3 位置焊接 SMTWE3311CTJ (M3*11 带螺纹支撑柱)

4) 从底层焊接面焊接 CN1 黑色栅栏端子, 焊锡要透到顶层元件面;

5) 电解电容 C100 和 C101:

- 按照丝印标识折弯管脚, 卧式贴线路板焊接;
- C301 和 C302 电解电容与 PCB 接触面涂覆 704 黑色固定胶, 点胶不要过量;

6) 变压器 T1 焊接前, 要对管脚的平整度进行调整, 避免出现管脚虚焊和变压器焊接后, 不在同一平面上;

7) 所有端口插座焊接需要压到底焊接, 不接受歪扭, 偏差要小于 0.3mm;

8) 所有极性元件, 严禁方向反;

9) 不接受虚焊, 空焊, 焊锡短路;

10) 未特殊说明的元件, 均紧贴线路板焊接;

11) 手工操作要做防静电处理;

12) 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准;

13) 贴装元件位置图详见焊接丝印图文件

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	